

威達誠實業有限公司 WEIDACHENG INDUSYRY CO., LTD

SOLDERING PLACEMENT SYSTEM 錫球植入機-BU-560

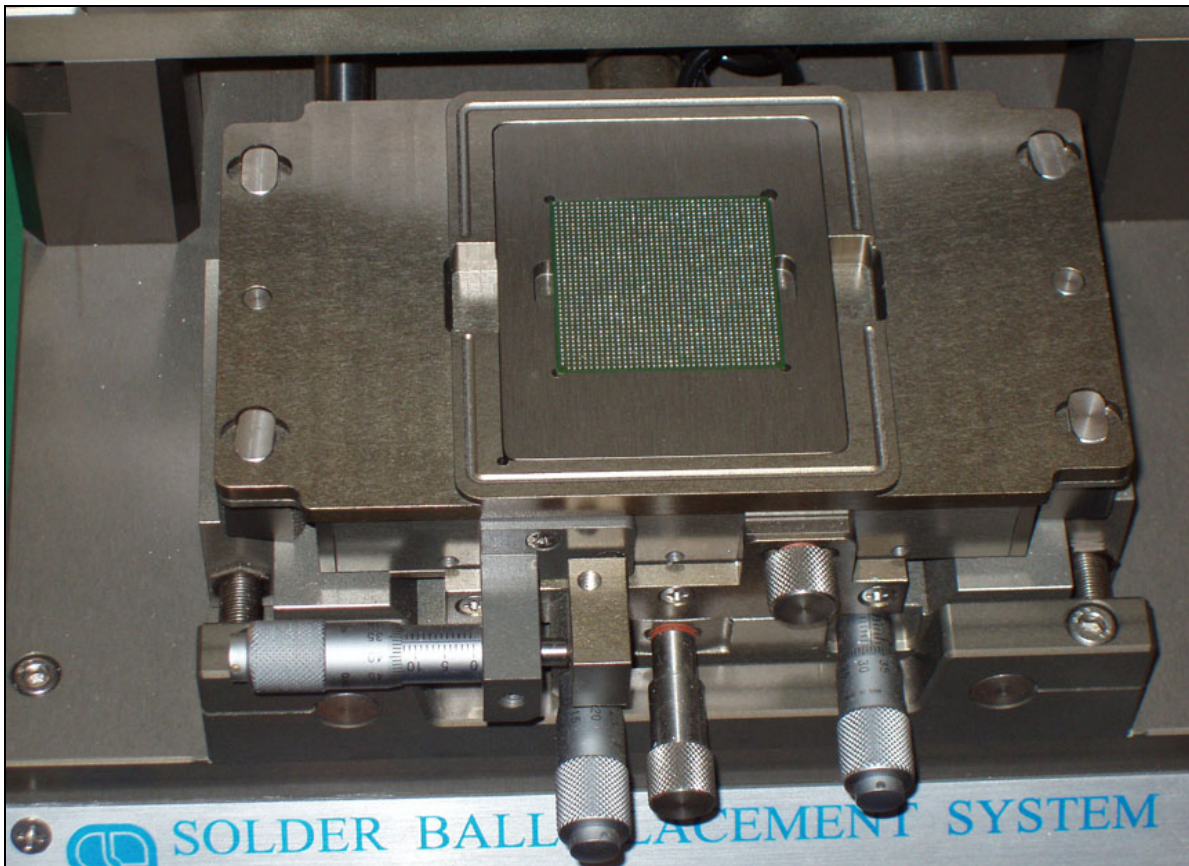
植球能力: $0.25\Phi\sim0.76\Phi$ 植球範圍:L-60mm .W-80mm



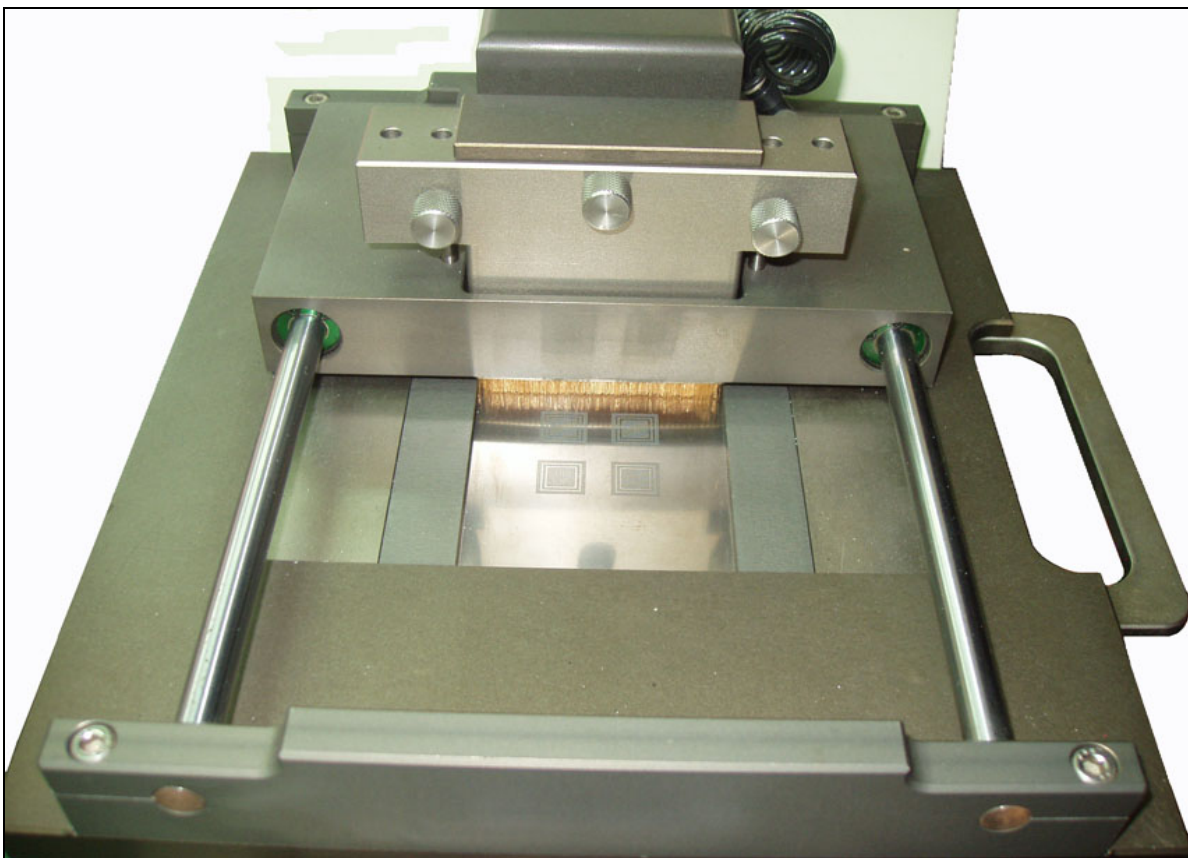
X. Y. θ 分厘卡調整滑座與 BGA-模具



35mmX35mm0.6 球徑 BGA 治具



0.25 球徑植球治具



14mmX14mm-0.25 球徑 BGA 治具



選購配備—離子淨電消除器(消除錫球帶電)



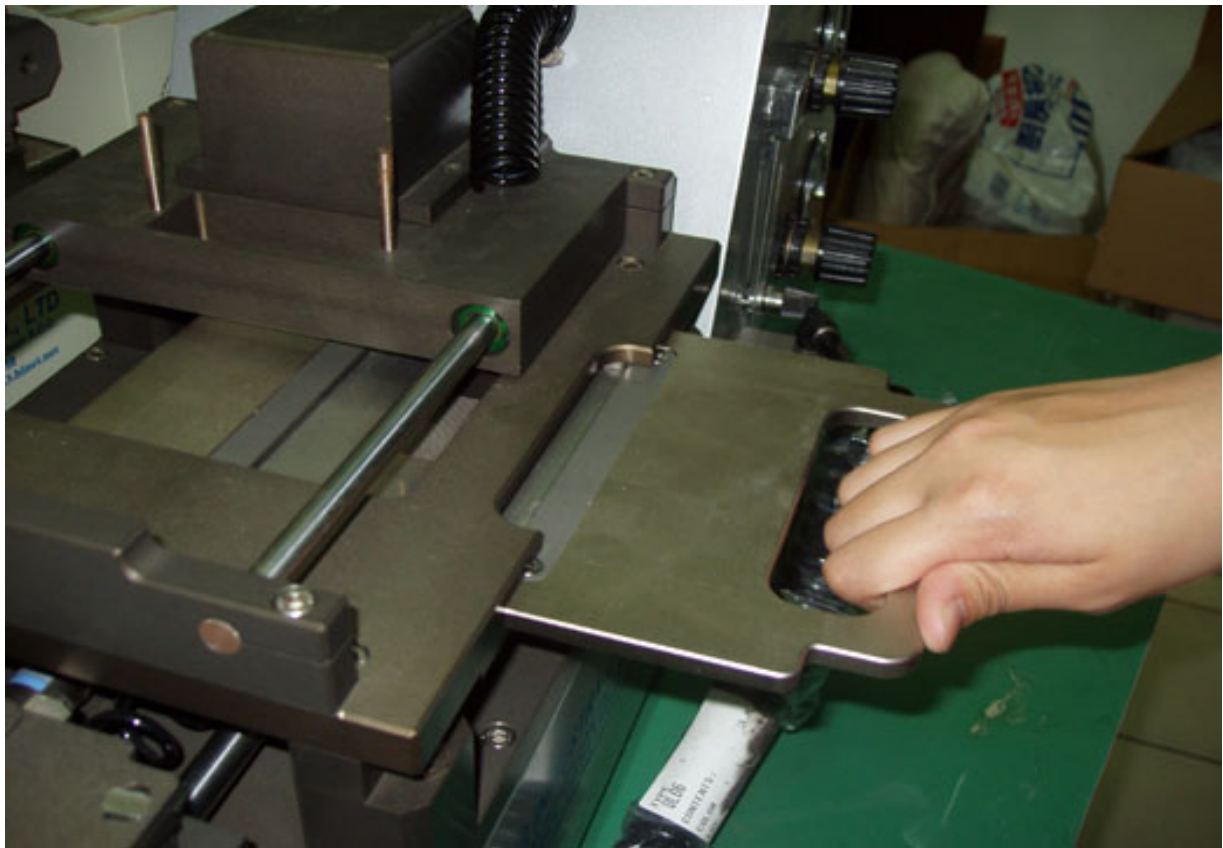
除球收集瓶座(清球配置)



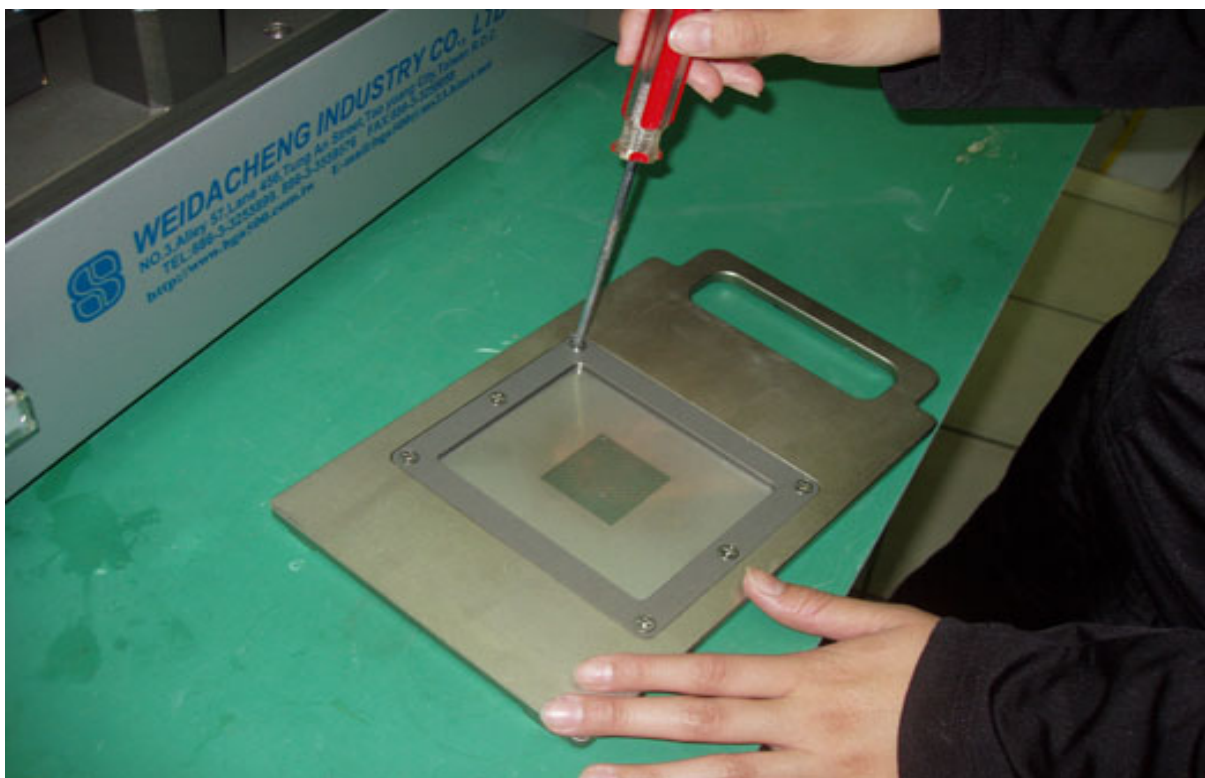
卡夾抽取式錫球模具更換座



抽取式更換植球鋼板

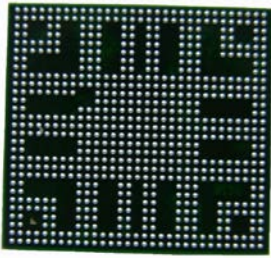


以十字螺絲起子鬆開螺絲，取下錫球模具鋼片
更換不同規格。

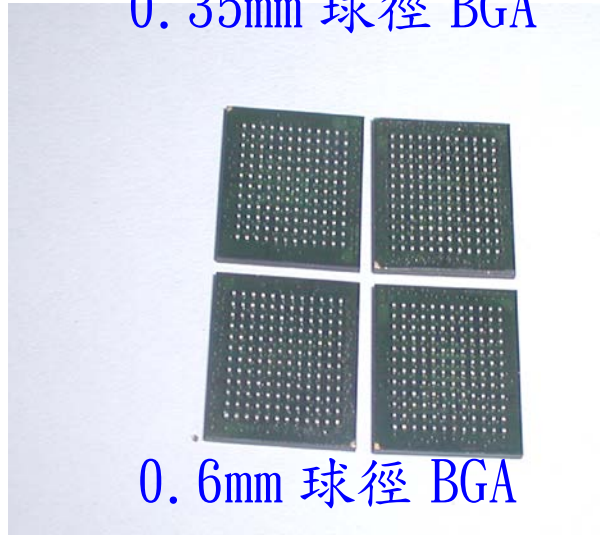


各類 BGA-IC 植球

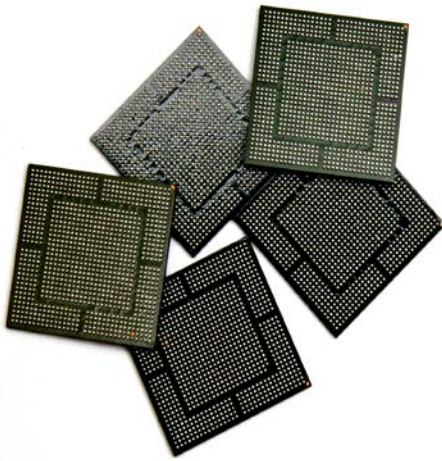
0.3mm 球徑 BGA



0.35mm 球徑 BGA



0.25mm 球徑 BGA



0.6mm 球徑 BGA



機器主要功能與結構

(a)設備規格:

1. 外部尺寸 : 75 cm(L)×25 cm(W)×30 cm(H)
2. 使用電壓 : **AC-220V50/60HZ**
3. 使用電流 : 1A
4. 重量 : 32 kg
5. 使用氣壓 : 6Kg/C m²
6. 植球能力 : 植球能力範圍12mil~ 30mil
7. BGA 模具 : 依 BGA 不同規格 SIZE 可更換需求錫球模具
8. 使用 SIZE : BGA 最大有效使用範圍規格 **60 mm×80 mm**
9. 適用元件厚度:**0.0875mm~3mm**
10. BGA 模具 : 依 BGA 不同規格 SIZE 可更換需求 BGA 模具.
11. 錫球植入率: 百分之 **98**

12. 錫球植入精度:0.03 mm.
13. 模具槽退料:退料速度 30 - 300 mm/S.
14. 自動植球時間:22/sec
15. 適用元件類別: PBGA, CBGA, CSP, BGA 角座
16. 位移方式: 模具與錫球模具吻合校正精密 X.Y. θ 滑台結構, 分離卡微調, 調整精確快速.
17. X 軸調整範圍 : 0~+5mm 0~-5mm (± 5 mm)
18. Y 軸調整範圍 : 0~+5mm 0~-5mm (± 5 mm)
19. θ 軸調整範圍 : 0°~+7° 0°~-7° (± 5 mm)
20. 氮氣流量調整範圍: 0~25 m³/min (1LPM=281/min)
21. BGA 模具更換方式: A. B. 定位 PIN 定位模具, 並具防呆功能, 防止反裝, 模具夾持採用筒壓扣, 勿需動用工具, 即可完成模具更換, 簡易又快速, 任何
23. 適用 BGA-IC 沒有規格 PIN 數及廠牌限制, 泛用性高、機動性高更換不同規格模具, 即可執行不同 SIZE 生產作業.
24. 錫球模具更換方式: 錫球模具固定座, 更換採抽取槽方式更換, 插入槽孔內並有定位功能, 模具固定座均可於更換後挾持位置固定不變.
25. 錫球收集清除: 備強力真空吸取錫球導入錫球收集瓶內, 完成清球動作.
26. 錫球槽防塵蓋: 防止塵埃污染並防止錫球槽填充氮氣大量外溢.

威達誠實業有限公司-技術部提供